



京鼎精密科技股份有限公司

2025第一季法人說明會

2025/06/24

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答交流

李貞誼

發言人

鄒永芳

財務長

邱耀銓

總經理

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

徐朝煌

協理



主要業務

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體設備及零部件再生循環
- 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療設備製造及設計服務

全球佈局 區域製造



2001
成立

2015
上市(3413TT)

3,647 員工人數
截至2025/5/30

NT\$ 10.78億 股本
截至2025/3/31

NT\$ 324.46億 市值
截至2025/05/29

2025年第一季營收
NT\$48.69億
+46.6% YoY

2025年第一季毛利
NT\$13.3億
+59.2% YoY

2025年第一季每股盈餘
NT\$ 6.71元
+21.6% YoY

全球佈局



生產基地：橫跨 4 區 7 廠，羅勇廠 Q1 啟用，春武里廠 Q3 完工



新產品開發中心



- ：營運製造據點-台灣-竹南/上海/江蘇
- ：營運製造據點(新增)-泰國
- ：新產品導入與少量生產據點-矽谷,USA
- ：銷售服務與國際採購據點-台灣/江蘇/加州/德州/亞利桑那州

財務報告

綜合損益表



單位：新台幣百萬元	1Q25		4Q24		QoQ%	1Q24		YoY%
營業收入淨額	4,869	100.0%	4,799	100.0%	1.5%	3,322	100.0%	46.6%
營業毛利	1,330	27.3%	1,228	25.6%	+1.7 pts	835	25.1%	+2.2 pts
營業費用	(453)	(9.3%)	(463)	(9.6%)		(353)	(10.6%)	
營業利益	877	18.0%	765	16.0%	+2.0 pts	482	14.5%	+3.5 pts
營業外損益	83	1.7%	250	5.1%		263	7.9%	
稅前淨利	960	19.7%	1,015	21.1%	-1.4 pts	745	22.4%	-2.7 pts
本期淨利	724	14.9%	789	16.4%	-1.5 pts	545	16.4%	-1.5 pts
歸屬予：								
母公司股東	724		789		-8.2%	545		32.8%
基本每股盈餘(元)	6.71		7.43		(0.72)	5.52		1.19
加權平均流通在外股數(百萬股)	107.91		106.15			98.91		

資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	1Q25		4Q24		1Q24	
現金及流動金融資產	9,760	41%	10,206	44%	10,921	54%
應收帳款	1,840	8%	1,695	7%	1,122	6%
存貨	4,032	17%	3,888	17%	2,587	13%
長期投資	528	2%	497	2%	359	2%
不動產、廠房及設備	5,891	25%	5,186	22%	3,994	20%
資產總計	23,575	100%	23,129	100%	20,161	100%
應付帳款	1,521	6%	1,712	7%	1,073	5%
銀行借款	1,653	7%	1,760	8%	1,811	9%
應付公司債	301	1%	323	1%	1,028	5%
流動負債	6,628	28%	5,549	24%	4,798	24%
負債總計	8,898	38%	7,921	34%	8,194	41%
股東權益總計	14,677	62%	15,208	66%	11,967	59%
重要財務指標						
平均收現天數	33		28		26	
平均銷貨天數	105		101		99	
平均付現天數	42		40		37	
淨營運現金週期天數	96		89		88	
流動比率(倍)	2.41		2.91		3.12	

現金流量表



單位：新台幣百萬元	1Q25	1Q24
期初現金	7,527	6,956
營運活動之現金流入	218	317
資本支出	(674)	(295)
定期存款	(225)	(544)
銀行借款淨變動	(106)	140
投資與其他	80	163
期末現金	6,820	6,737
自由現金流量*	(456)	22

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

營運與展望

營收趨勢

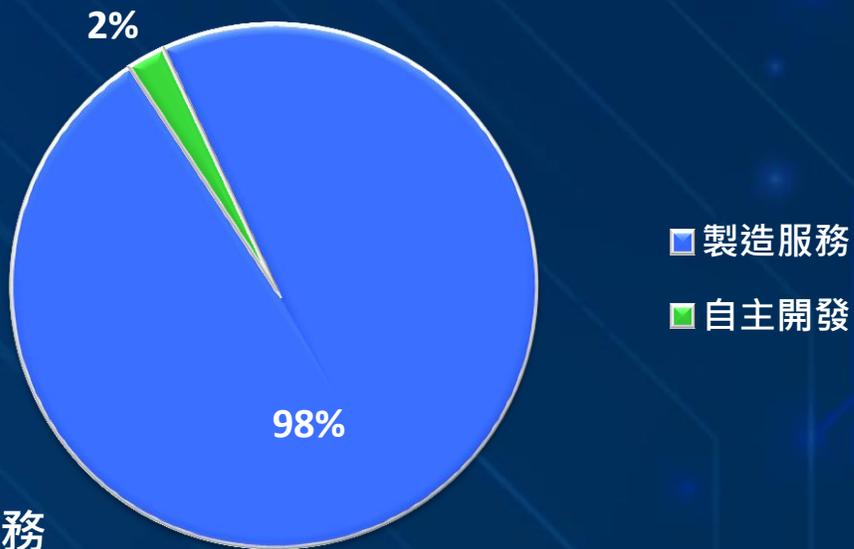


■ Q1營收**48.69**億元，YoY **+46.6%**、QoQ **+1.5%**；連續四季成長，並創歷史新高。



註：製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造；自主開發=自動化設備

2025年第一季銷售分析-業務別

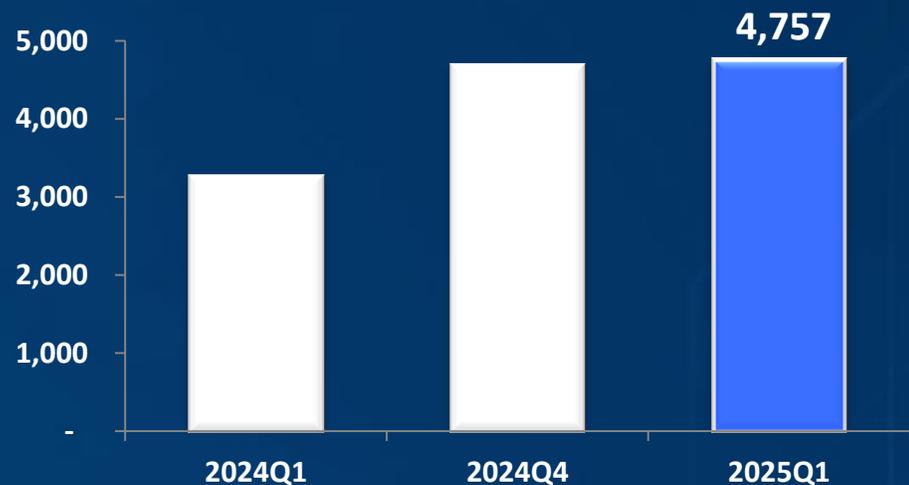


製造服務

+1.6% QoQ

+46.2% YoY

單位：台幣百萬

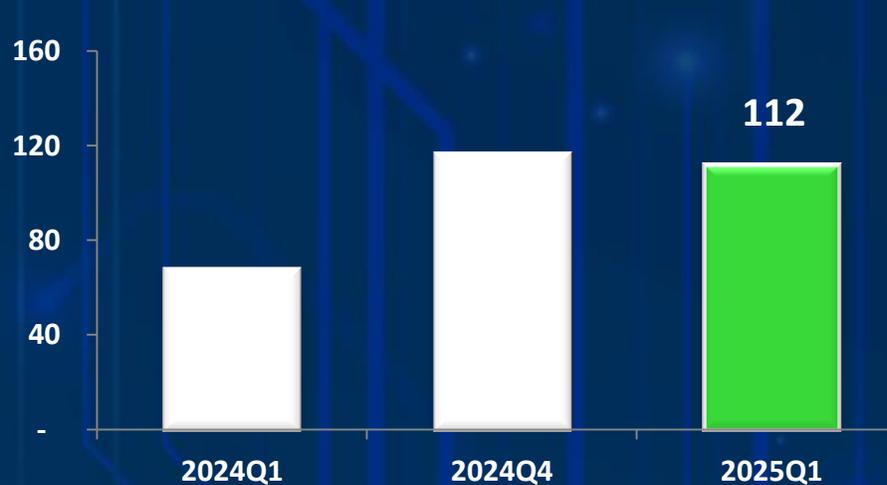


自主開發

-3.9% QoQ

+64.5% YoY

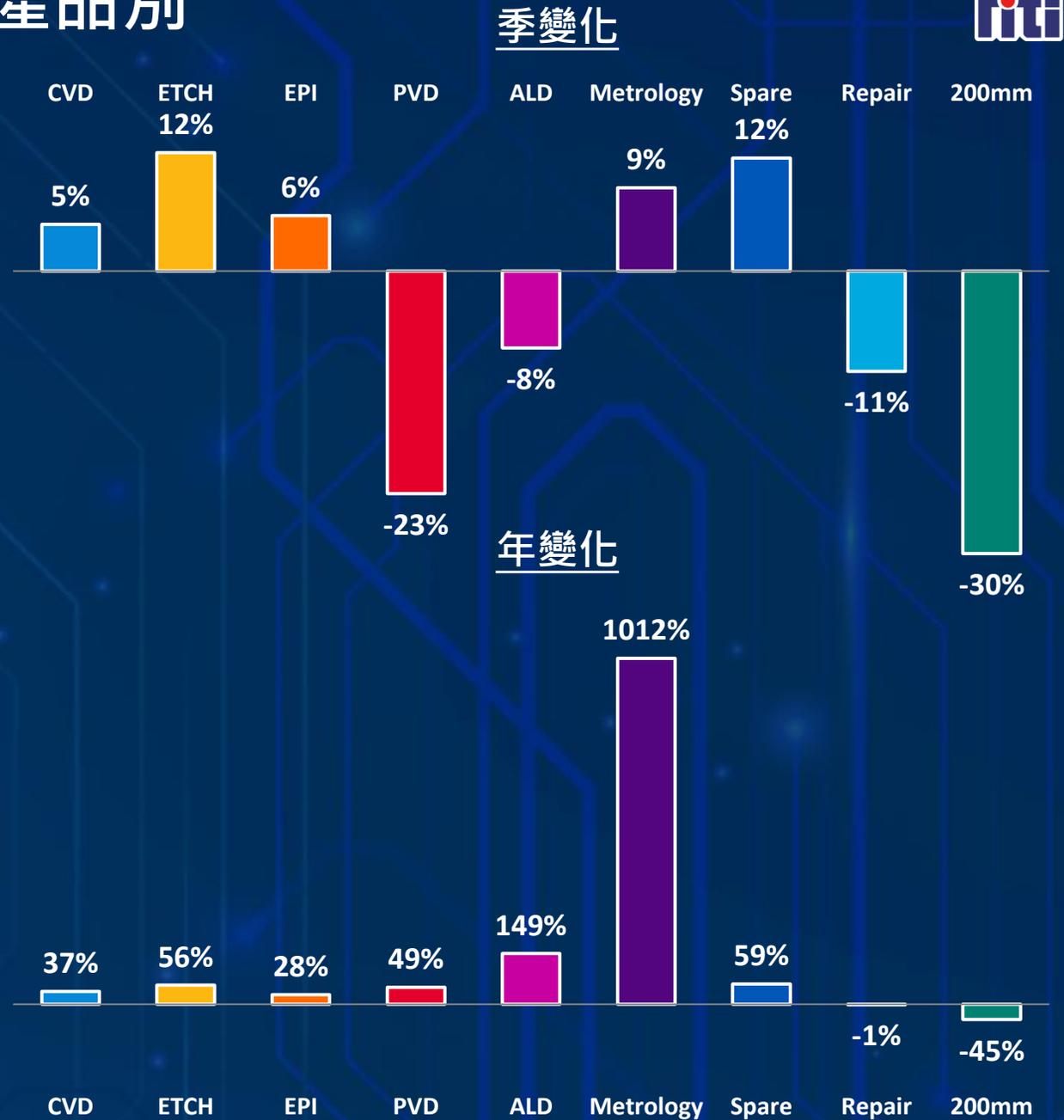
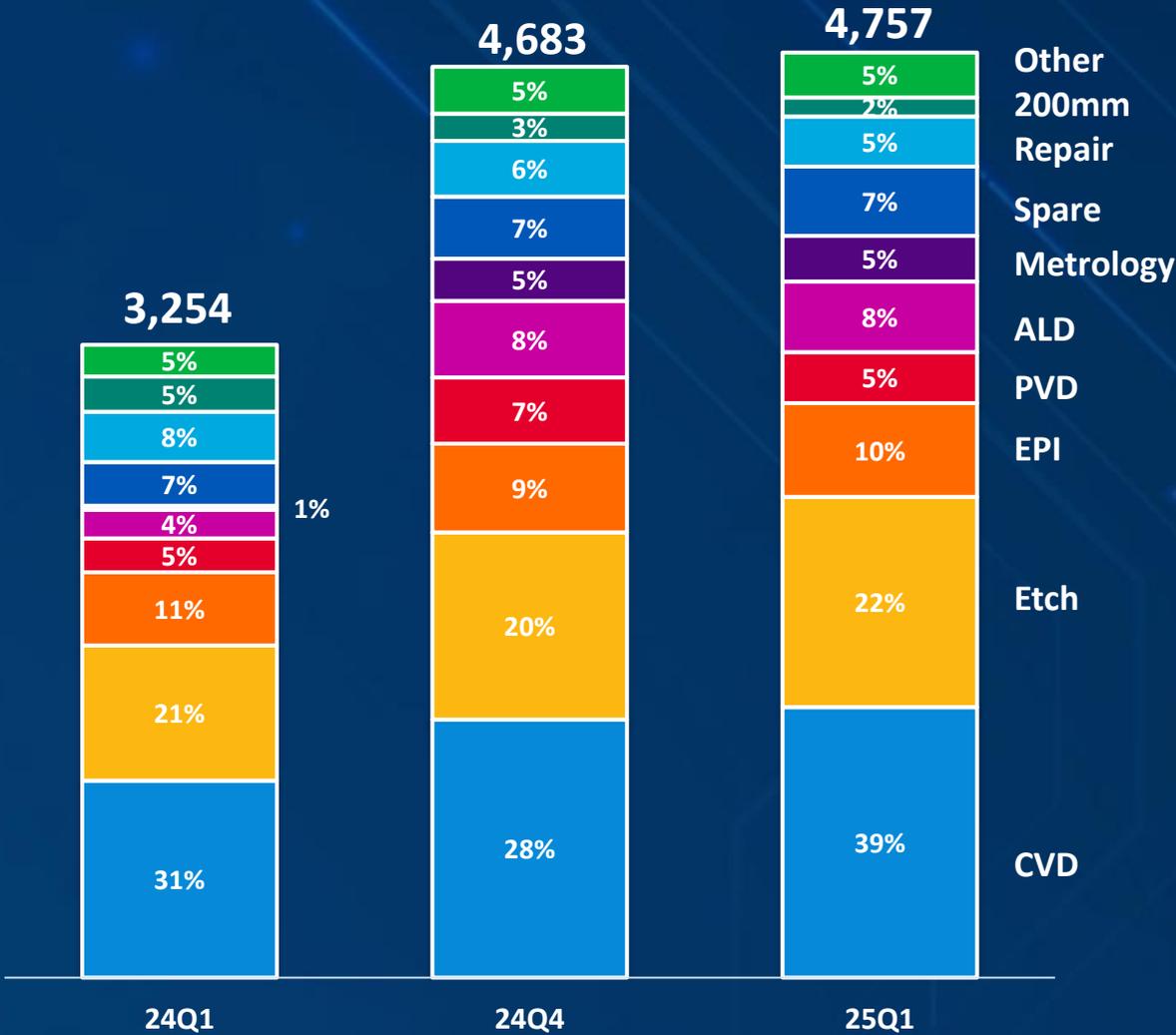
單位：台幣百萬





2025年第一季製造服務銷售分析-產品別

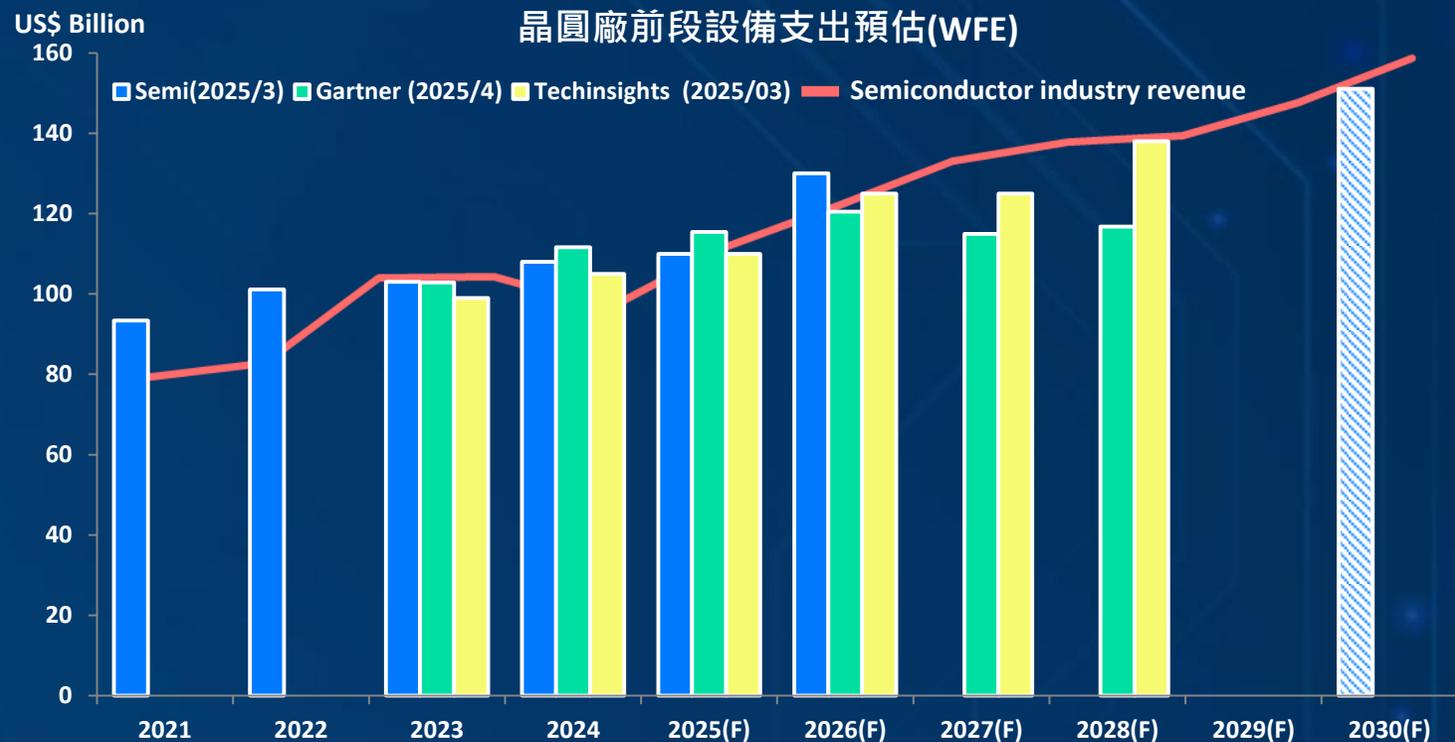
單位：台幣百萬



產業趨勢



- 2025 年 WFE 市場預期溫和成長 2%–5%。AI 與 HPC 應用推動先進邏輯 (GAA、BSPDN) 與高階記憶體 (HBM、DDR5) 設備需求持續成長，部分抵銷中國投資放緩影響
- 展望 2026 年，WFE 市場可望年增 4%–18%。隨著 AI 應用持續深化，晶片結構與製程複雜度提升，帶動蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵製程設備資本支出擴大
- 新興應用推動半導體需求與矽含量上升，製程技術日益精密，加上地緣風險升高，半導體供應鏈加速在地化布局，進一步推升設備市場持續成長



WFE(\$B)	2024	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)
Semi (2025/3)	108	110	130		
YoY	5%	2%	18%		
Gartner (2025/4)	112	115	120	115	117
YoY	9%	3%	4%	-5%	2%
TechInsights (2025/3)	105	110	125	125	138
YoY	6%	5%	14%	-	10%

Source:Semi/Gartner/TechInsights

2025年第二季展望



■ 營運成果

- Q1雙率雙升，營收、獲利創同期新高
- 通過 ISO 27001 認證，全面強化資安，接軌國際標準
- 目前關稅影響可控，於台灣、泰國、大陸與美國多點布局，展現供應彈性與應變能力
- 泰國羅勇廠產品認證通過，Q2 進入量產階段，產能將逐步開出
- 檢測設備新專案陸續導入，將有助於下半年營運表現

■ 營運展望及成長策略

- Q2 營收可望再創高點，上半年表現亮眼，下半年仍需審慎觀察關稅與匯率帶來的不確定性
- AI 與 HPC 應用擴大先進製程與先進封裝投資，帶動 WFE 市場穩健成長
- 晶片結構與製程複雜度提升，進一步推升蝕刻、薄膜沉積與檢測設備需求
- 攜手富蘭登，擴大產品與客戶布局，強化垂直整合製造優勢，開拓新成長曲線

Q&A





Thank you